SMT時代に対応

RF-110

RF-110N2

手動式リフローはんだ付け装置　RF-110
手動式 N_2 リフローはんだ付け装置　RF-110N2

RF-110は手動式遠赤外線リフローはんだ付け装置です。200×200mmまでのプリント基板を両面リフローはんだ付けできます。少量多品種 SMT 基板の生産や、実験・試作に最適です。

RF-110N2 は RF-110 の窒素(N_2)対応品です。わずかな窒素の消費で、1000ppm 以下の酸素濃度を実現します。

特　長

○ 遠赤外線(IR)1 ゾーン加熱です。タイマーとデジタル温度調節器により、温度プロファイルを設定できます。
○ 200 × 200mm の基板まで、接着剤なしに両面リフローはんだ付けできます。
○ 世界で最も小型で、安価な卓上窒素(N_2)リフローはんだ付け装置です。(RF-110N2)
○ 1 回のリフローはんだ付けに、20 ～ 30ℓ とわずかな窒素量で酸素濃度1000ppm 以下を達成します。(RF-110N2)

仕　様

・加熱部	:1 ゾーン 210mm × 210mm 高さ20mm
ヒーター	:石英管ヒーター IR （波長:2 ～ 10 μ m）
	上部 :1kW 下部 :0.4kW
ヒーター選択	:TOP （上部のみON） / OFF / FULL （上下共にON）
温度制御	:Max300℃ P.I.D. 温度調節器
	上部炉内雰囲気温度制御
・コンベア	:無し （バッチ式）
・タイマー	:0 ～ 10 分 アナログ式タイマー
・冷　却	:自然空冷
・電　源	:AC100/120/220V 1.5kW 50/60Hz
・N_2 供給量	:20 ～ 30ℓ/ 回 （1回は2 分 30 秒）
(RF-110N2)	窒素の供給は開始からタイマーOFF までの間。
・外形寸法 ・重量	:(W)300 ×(D)550 ×(H)195mm 約 12kg (RF-110)
	(W)340 ×(D)590 ×(H)210mm 約 14kg (RF-110N2)

適合基板

寸法 :10mm × 10mm
～200mm × 200mm
板厚 :0.1mm ～ 2mm
高さ :MAX20mm

用　途

・H-IC や SMT 基板のリフローはんだ付け。
・非洗浄タイプクリームはんだのリフローはんだ付け。(RF-110N2)
・BGA パッケージへのボールはんだ搭載。
・熱硬化接着剤の乾燥。
・その他加熱作業。

オプション

・動作表示灯

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社日本パルス技術研究所

本　　社／〒 372-0804 群馬県伊勢崎市稲荷町 425-3 TEL 0270-23-1031
前橋事業所／〒 379-2122 群馬県前橋市駒形町 506-3 TEL 027-266-6381
Mail:info@jpl.co.jp http://www.jpl.co.jp/ FAX 0270-23-1943